

2017/09/22

风险等级：低风险

赢家日报白金版 0922

【赢家视点】

1. **资金流向**：上一交易日主力资金流入前三的行业为（单位：亿元）：商业百货（+2.90）、保险（+2.44）、银行（+1.15）；主力资金流出前三的行业为（单位：亿元）：有色金属（-59.60）、化工行业（-29.44）、电子元件（-28.31）。

2. **策略**：周四，沪深两市冲高回落，午后调整幅度逐步扩大，上证指数下跌 0.24%，报收 3357.81 点；深成指下挫 0.83%，报收 11098.34 点；创业板指跌幅 1.05%，报收 1872.77 点。两市合计成交 5526.49 亿元，沪股通净流入 8.79 亿元，深股通净流入 4.06 亿元。盘面上，租售同权、保险、银行、5G 板块涨幅靠前，有色金属、贵金属、煤炭采选、房地产板块领跌。

上一交易日，大盘在金融板块的带动下上攻 3370 点压力位，无奈量能不足且前期热点板块纷纷熄火，最终指数持续回调并收出一根倒锤线。我们认为，大盘 3400 点久攻不破，上方压力逐步显现，再加上近日市场受节前效应影响，交易热情降温、赚钱效应减弱，短期大盘存在调整压力。但在市场监管层面的呵护下，大盘大概率维持震荡整固的态势。建议投资者控制仓位，继续关注大金融、大消费、人工智能、新能源、消费电子板块中相对滞涨的优质个股，如遇急跌可适当加仓。

【要闻梳理】

1. 9月21日，央行公开市场进行 400 亿元 7 天期逆回购操作，200 亿元 28 天期逆回购操作。当日有 600 亿逆回购到期。
2. 标普：中国评级从 AA-调整至 A+，展望从负面调整至稳定。
3. 针对近期“美国一些大企业的投诉在中国要被迫设立合资企业，转让技术”说法，商务部新闻发言人高峰回应，中国没有任何一部法律强制外国投资者转让技术。

4. 9月21日,北京市政路桥股份有限公司增资协议签约仪式在北京产权交易所举行,“北京市政路桥”携手上海金砖股权投资基金,共同打造北京市属国企混合所有制改革典范。
5. 商务部表示,我国新能源汽车产业一直坚持开放发展的原则,下一步,将按要求协调推动有关部门,尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施。
6. 近日,民政部等6部门和单位联合印发了《关于开展国家康复辅助器具产业综合创新试点的通知》,决定在全国选择12个地市级行政区域开展创新试点。希望通过试点,将康复辅助器具产业打造成为推动经济转型升级的先导产业,产业增速超过本地区GDP增速。
7. 商务部表示,将继续密切关注无人零售的发展,广泛了解零售企业技术应用的情况,深入分析技术创新的方向,适时发布《零售业技术创新框架》和技术应用典型案例,引导广大零售企业加大先进技术应用,不断增强创新转型能力,更好地适应消费升级的需求。
8. 住建部发布支持北京市、上海市开展共有产权住房试点的意见,要确保共有产权住房用地供应,并落实好现有的财政、金融、税费等优惠政策。
9. 陕西省国资委:前8个月,省国资委36户监管企业累计利润总额201.8亿元,同比增加117.7亿元,增长139.9%,完成全年目标任务的100.9%。
10. 三大运营商8月的运营数据显示:整体来看,三大运营商的移动用户数增速平稳,和前几个月维持在统一水平线上。但在4G方面,中国移动依然领跑,中国联通本月增速明显,中国电信则是中规中矩。

【新股申购】

【新股】横店影视(申购代码 732103),发行价格 15.45,申购上限 1.50 万股,顶格申购需配市值 15.00 万元。

威唐工业(申购代码 300707),发行价格 15.09,申购上限 1.95 万股,顶格申购需配市值 19.50 万元。

【东方研究】

电子行业

先进封测技术引领未来趋势。(1) SiP 技术:随着移动设备和可穿戴装置等轻巧型产品需求渐旺, SiP 技术凭借体积小、开发周期短、功能多、质量轻等优点,将引领封装产业未来发展趋势。(2) Fan-out 技术:Fan-out 技术开发周期短,不需使用基板材料,降低了成本,

封装厚度也更加轻薄，非常契合当前电子产品的发展趋势需求。随着 iPhone 7 中采用 Fan-out 技术，在创造出庞大需求量的同时，亦将吸引其他智能手机芯片从业者加大对 FoWLP 技术的投入，未来市场空间弹性足；(3) TSV 技术：TSV 技术使芯片间的互连更短，满足器件的高频特性，并且对于 MEMS 的集成封装也有实用价值。TSV 技术的出现为 CIS、指纹识别等应用升级打开了空间。

当前半导体行业景气度旺盛，行业销售额、设备出货数据均表现出强劲态势，国家在政策和财力两方面对半导体产业扶持力度强劲，大陆 IC 设计公司高速增长，晶圆厂建厂潮兴起，都将带来配套封装测试需求。在产业景气度旺盛以及政策扶持等因素的助力下，国内封测厂商通过内生和外延的方式在先进封装技术领域不断取得突破，市场竞争力和行业地位显著提升，成长空间广阔。

风险提示：半导体产业景气度下滑；Fan-out、SiP、TSV 等先进封测技术进展不及预期。

【免责声明】

本报告(或刊物、资讯,以下统称:报告)由东方证券股份有限公司财富管理业务总部编撰、制作及发布本营业部的客户。

本报告是基于本部门认为可靠的或目前已公开的资讯、信息进行摘录、汇编或撰写,本部门对报告所载内容始终力求但不保证该信息的准确性和完整性。“东方研究”摘自东方证券研究所已发布的研究报告,东方证券研究所的研究观点应以正式发布的东方证券研究报告为准。其他信息来源主要有 wind 资讯、东方财富网、中财网、证券之星等各大财经网站,本报告不能保证所有信息的真实性和可靠,请投资者阅读时注意风险。

在任何情况下,本报告所载信息、意见、推测或观点仅反映本部门于发布报告当日的判断,且不构成对任何人的投资建议,亦非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人发出邀请。投资者应通过正规渠道获取产品服务,根据个人风险承受能力评估结果、个人投资目标、财务状况和需求来判断是否借鉴、参照报告所载信息、意见或观点,独立作出投资决策并自行承担相应风险。

在任何情况下,本部门及其员工不对任何人因援引、使用本报告中的任何内容所引致的任何损失及后果负有任何责任。

任何机构或个人未经本部门事先许可不得就本报告的全部或部分内容擅自引用、刊发或转载,亦不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用的证明或依据,不得用于赢利或其他未经允许的用途。



部门团队

财富管理业务总部
东方赢家财富管理团队



联系方式:

上海市中山南路 318 号
东方国际金融广场 2 号楼 13 楼
邮编:200010
电话:021-63325888
邮件地址:orientwinners@orientsec.com.cn